

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和6年4月4日(2024.4.4)

【公開番号】特開2023-127609(P2023-127609A)

【公開日】令和5年9月14日(2023.9.14)

【年通号数】公開公報(特許)2023-174

【出願番号】特願2022-31382(P2022-31382)

【国際特許分類】

H 01 L 23/34 (2006.01)

10

【F I】

H 01 L 23/34 B

【手続補正書】

【提出日】令和6年3月27日(2024.3.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0003】

【特許文献1】特開2012-142465号公報

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0054

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0054】

図8に示すように、実施の形態5では、実施の形態3に対して半導体モジュール10は、複数(例えば2つ)の金属部材13を備えている。金属部材13と半導体素子14との接続関係は2つとも同じである。一方(図8において左側)の半導体素子14の上面電極はリード電極15の一端部と接合材21を介して接合され、他方(図8において右側)の半導体素子14の上面電極はリード電極22の一端部と接合材21を介して接合され、一方の半導体素子14が搭載された金属部材13の上面はリード電極22の他端部と接合されている。また、他方の半導体素子14は接続配線17を介してリード電極16の一端部と接続されている。なお、実施の形態5の構造を実施の形態1~4の構造に採用することも可能である。

30

40

50